公司代码:603501　　公司简称:韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为:公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),预计分配现金红利总额为60,450,361.86元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.98%。公司2019年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾渊	任冰
办公地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电话	021-50805043	021-50805043
电子信箱	stock@sh-willsemi.com	stock@sh-willsemi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

考虑到公司半导体设计业务及半导体分销业务并存的特性,根据行业及公司现状,公司在经营模式上有效整合了半导体设计和分销业务。公司设计业务依托公司分销业务的渠道优势,利用分销体系分析的客户需求信息,有针对性的提供满足客户需求的产品,并为公司产品研发方向提供市场信息作为参考。同时,公司分销业务凭借设计业务积累的技术优势,能为下游客户提供更好的解决方案,保证公司在分销业务市场的竞争优势。

1、半导体设计业务

(1)公司采用Fabless的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的Fabless模式,公司仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商,公司从晶圆代工厂采购晶圆,委托集成电路封装测试企业进行封装测试。

公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜,以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购,公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司,市场知名度高,与公司有着长期稳定的合作关系,产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内,公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司,经营稳定,市场知名度较高,能够按照产能和周期安排订单生产,报价基于市场化原则,公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广,根据行业、产品及市场需求情况,公司和应选择直销和代销的方式进行销售。总体而言,公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、OEM厂商、OEM厂商及终端客户,直销模式可以保障公司服务效率,根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整、除直销外,公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式,公司可有效降低新客户开发的成本,在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时,也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

(2)公司设计业务产品类型

公司研发设计的半导体产品主要包括图像传感器产品和其他半导体器件产品两大产品类型,具体产品包括以下部分:

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
CMOS图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号,处数字摄像头的重要组成部分	消费类电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等	8万像素到400万像素领域全覆盖,可实现摄像头更高速的自动对焦;降低功耗并保障了图像质量;显著提动物体,且不会产生空间失真;可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内核式图像信号处理等方面的区别,提供特色化的产品解决方案
微型影像模组封装(Camera Cube Chip)	采用先进的芯片级封装技术整合集成镜组给光学器件和CMOS图像传感器创新的解决方案,可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、手机、物联网、AR/VR眼球追踪等	目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一;提供业界最小的相机模组解决方案;使用半导体工艺制造镜头;可过回流焊,无需底座或人工插接模组
硅基液晶投影显示(LCOS)	反射模式,尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗机械等	LCOS将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高通光率,从而达到更大的光输出和更高的分辨率。为微型投影系统提供了一个高解析度(HD)、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案
特定用途集成电路产品(ASIC)	支持公司CMOS图像传感器,在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用,提供USB、并行、串行接口解决方案以及压缩信号和低功耗图像信号处理等功能	汽车等	支持高动态范围、多路环视影像处理,同时支持鱼眼矫正、畸变图、图像叠加等高级图像处理功能,提供完美的汽车影像解决方案;可进行多路摄像头的拓展,并且支持多幅图像的拼接处理
TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	采用先进的沟槽技术和超薄化封装技术,可提供最小封装尺寸为0.6mm*0.3mm规格封装的产品,并已进入国内第一批电容小于0.4PF产品的量产阶段,其ESD性能具备国际领先水平
MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	拥有多层外延技术,背面减薄技术和芯片侧装技术等多项核心技术,目前最小pitch(特征尺寸)小于1μm,最小设计线宽小于0.2μm
肖特基二极管	电源整流,电流控向,截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	采用先进的沟槽技术,产品具有优异性能指标及电学参数
LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、恐沙放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富,并形成专利技术
DC-DC	起调压的作用(开关电源),同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富,并形成专利技术
LED背光驱动	构造一个恒流源电路,确保任何条件下背光LED的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富,并形成专利技术
模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富,并形成专利技术
直播芯片	对高清数字信号解码、输出等	机顶盒	拥有丰富的Soc芯片设计经验和先进工艺设计的物理实现经验积累
射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信	提供国内首创多模/多频功放新架构射频芯片,并开发了TD-LTE射频功放技术
MEMS麦克风	实现声信号转换为电信号	消费类电子如智能音箱、无线耳机等	应用特有的封装结构提高声学性能,尺寸小,高信噪比,功耗低

2、半导体产品分销业务

(1)半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商,与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的FAE队伍,顺应国内半导体行业的产业地域布局,公司分销体系境内外多地设立了子公司,构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式,具体分为境内采购和境外采购两部分:①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行;②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析,公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本,以便其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广,同时也能更好的了解客户的需求,进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求,代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

(2)半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件(包括电阻、电容、电感、晶体、接插器、连接器等)、结构器件、分立器件、IC、显示屏模组等。

产品名称	细分产品	主要代理原厂	应用领域
被动件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、AVX、LITE、WALSIN、HEC等	移动通信、家用电器、安防电子、数码产品、智能穿戴、金融支付、工业设备、电力设备、电机控制、电源、仪器仪表、汽车及部件、消防、照明、轨道交通等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB等	Molex、松下、南亚等	
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、VISHAY等	
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash等	光宝、江波龙、XMC、Zetta、ISSI等	
射频器件	滤波器等	松下、ACX等	
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT等	智晶、LGD等	车载市场

公司会根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素,对所代理的产品线进行动态管理。在开发新产品线的同时,对某些竞争力较弱、可替代性较高等不符合公司分销业务发展战略的产品公司进行过滤,将逐步降低代理数量或不再代理。由于终端设备市场产品更新换代速度较快,公司需同下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系,在及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求的基础上,有针对性的进行技术研发和储备,使企业的新技术能顺应市场变化,减少下游行业变化带来的负面影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	17,476,223,432.68	15,589,356,096.62	4,599,872,273.92	12.10	2,824,908,203.63
营业收入	13,631,670,629.57	9,701,902,368.56	3,963,509,424.61	40.51	2,405,916,266.81
归属于上市公司股东的净利润	465,632,238.67	144,991,902.55	138,804,364.26	221.14	137,156,318.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,201,677.11	132,553,764.37	132,553,764.37	152.13	120,567,028.45
归属于上市公司股东的净资产	7,926,394,295.30	3,983,942,540.00	1,635,555,967.17	98.96	1,179,764,415.88
经营活动产生的现金流量净额	806,335,234.79	790,006,614.66	5,401,858.32	1.94	-271,954,275.88
基本每股收益(元/股)	0.76	0.29	0.32	162.07	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.30	0.33	143.33	0.34
加权平均净资产收益率(%)	10.17	4.94	10.08	增加5.23个百分点	13.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,646,467,818.64	3,056,953,676.46	3,702,551,908.30	4,225,697,226.17
归属于上市公司股东的净利润	49,454,973.86	26,346,407.09	59,325,080.47	330,505,777.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,735,317.91	-11,487,192.89	46,446,207.80	272,507,344.29
经营活动产生的现金流量净额	-409,155,417.77	455,312,166.10	-290,751,168.24	1,049,929,655.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2019年8月28日,公司已完成北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)42.27%股权、北京视信源科技发展有限公司(以下简称“视信源”)79.93%股权登记手续,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续。本次收购完成后,北京豪威成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司与北京豪威在合并前后均受控股股东虞仁荣先生控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并,追溯调整前期财务报表数据。

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与第四季度差异较大主要是因为:同一控制下企业合并会计处理造成,2019年9月至2019年12月北京豪威实现的利润全部归属于上市公司股东净利润。

公司各季度经营活动产生的现金流量净额差异较大主要是因为:公司营业收入增加,销售商品收到现金相应增加;公司第三、四季度营业收入增长较多,2019年9月当月营业收入大幅增长,销售收到的现金在第四季度实现。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

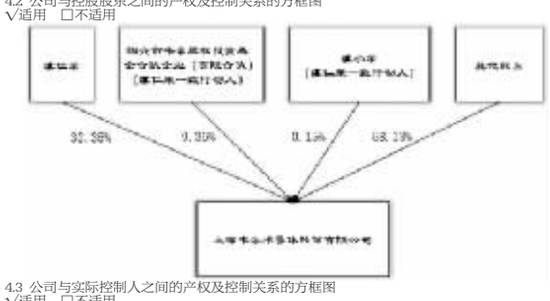
截止报告期末普通股股东总数(户)	23,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,076
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
虞仁荣		279,435,000	32.35	279,435,000	质押	151,010,205	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,839,009	80,839,009	9.36	80,839,009	质押	80,839,009	境内非国有法人
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	62,187,073	62,187,073	7.20	62,187,073	无		境内非国有法人
Seagull Strategic Investments(A3),LLC	30,980,219	30,980,219	3.59	30,980,219	无		境外法人
嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	26,814,084	26,814,084	3.10	26,814,084	无		境内非国有法人
嘉兴豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	26,814,084	26,814,084	3.10	26,814,084	无		境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	22,997,032	22,997,032	2.66	22,997,032	无		境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	22,901,063	22,901,063	2.65	22,901,063	无		境外法人
香港中央结算有限公司	22,263,903	22,263,903	2.58		无		境外法人
深圳金石中睿投资管理有限公司-开元朱雀(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	20,330,959	20,330,959	2.35	20,330,959	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业,虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟,均为虞仁荣先生一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

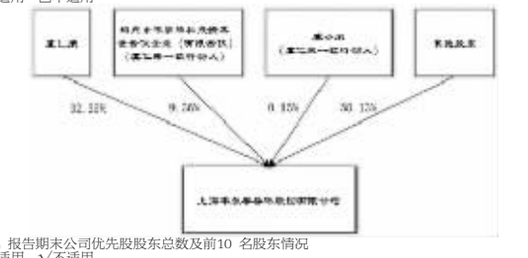
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业总收入136.32亿元,较2018年追溯调整后营业总收入增长40.51%;公司归属于母公司股东的净利润为4.66亿元,较2018年追溯调整后归属于母公司股东的净利润增加221.14%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额		
		合并	母公司	
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第五届董事会第二次会议、第五届监事会第七次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额6,776,206.89元,“应收账款”上年年末余额1,483,043,120.74元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额100,000,000.00元,“应付账款”上年年末余额1,295,432,827.27元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额823,460,740.23元,“应收账款”上年年末余额284,461,508.66元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额11,759,405.19元。	
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第五届董事会第二次会议、第五届监事会第七次会议	无影响	无影响	

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	第四届董事会第三十八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少12,569,951.68元。交易性金融资产:增加12,569,951.68元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少9,320,000.00元。交易性金融资产:增加9,320,000.00元。
(2)将部分“应收款项”重分类至“应收票据融资”	第四届董事会第三十八次会议	应收票据:减少95,776,206.89元应收票据融资;增加95,776,206.89元	应收票据:减少23,460,740.23元应收票据融资;增加23,460,740.23元
(3)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产:减少29,370,000.00元其他非流动金融资产;增加21,360,000.00元留存收益:减少7,209,000.00元递延所得税资产;增加801,000.00元	可供出售金融资产:减少29,370,000.00元其他非流动金融资产;增加21,360,000.00元留存收益:减少7,209,000.00元递延所得税资产;增加801,000.00元
(4)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产:减少56,160,602.36元其他权益工具投资;增加49,974,590.67元其他综合收益;减少6,186,011.69元	无影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
上海韦矽微电子有限公司
韦尔半导体香港有限公司
合肥韦豪半导体技术有限公司
北京泰合志恒科技有限公司
武汉泰合志恒科技有限公司
上海矽久微电子有限公司
无锡中普微电子有限公司
安靖利科技有限公司
上海韦劲微电子有限公司
无锡韦尔半导体有限公司
上海磐巨电子科技有限公司
武汉耐普登科技有限公司
武汉韦尔半导体有限公司
武汉韦尔投资管理有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司
上海爽易半导体有限公司
绍兴韦豪半导体科技有限公司
深圳市芯力投资有限公司
绍兴豪威半导体有限公司
深圳市芯力投资有限公司
香港华清电子(集团)有限公司
香港鸿光兴盛电子有限公司
北京京鸿志科技有限公司
深圳市京鸿志电子有限公司
苏州京鸿志电子有限公司
深圳市京鸿志物流有限公司
鸿光电子元件(深圳)有限公司
上海灵心电子科技有限公司
香港灵心电子科技有限公司
深圳东益电子有限公司
香港东意电子有限公司
上海树国电子科技有限公司
香港树伟明电子科技有限公司
北京豪威科技有限公司
Seagull Investment Holding Limited
Seagull International Limited
Omni Vision Technologies, Inc.
Omni Vision International Holding Limited
Omni Vision Technology International Ltd.
Omni Vision Technologies (HongKong) Company Limited
Omni Vision Trading (HongKong) Company Ltd.
Omni Vision Technologies Development (HongKong) Company Limited
豪威半导体(上海)有限责任公司
豪威科技(上海)有限公司
台湾豪威科技有限公司
台湾豪威国际科技有限公司
Omni Vision Holding (HongKong) Company Limited
Omni Vision Investment Holding (BVI) Ltd.
北京豪威亦庄科技有限公司
上海全芝半导体技术有限公司
Omni Vision Optoelectronics Company Limited
豪威光电子科技(上海)有限公司
台湾豪威光电科技股份有限公司
Omni Vision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited
Omni Vision Technologies Norway AS
Omni Vision Technologies Singapore Pte.Ltd
豪威科技(武汉)有限公司
Omni Vision Technologies Japan G.K.
Omni Vision CDM Optics, Inc.
北京视信源科技发展有限公司
北京思比科微电子技术股份有限公司
思比科(香港)有限公司
太仓思比科微电子技术有限公司
天津安泰微电子技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告“第十一节 财务报告7/八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603501　　证券简称:韦尔股份　　公告编号:2020-017

上海韦尔半导体股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月7日签发的证监许可[2017]469号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》,上海韦尔半导体股份有限公司获准公开发行新股不超过4,160万股,每股发行价格为人民币7.02元,股款以人民币缴足,计人民币292,032,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,685,000.00元后,净募集资金共计人民币241,347,000.00元,上述资金于2017年4月27日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2017]第ZA14314号验资报告。

截至2019年12月31日止,本公司累计使用首次公开发行募集资金投入募集项目198,803,374.84元(其中置换以自筹资金预先投入募集资金为81,035,500.03元),募集资金专户余额为185,237.39元。

2、2019年非公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司2019年度向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)7,006,711股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币57.68元,共计募集资金总额为人民币404,147,090.48元,扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币37,291,138.43元后,实际募集资金净额为人民币366,855,952.05元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2019]第ZA15427号验资报告。

截至2019年12月31日止,本公司累计使用2019年度非公开发行募集资金投入募集项目78,636,354.27元(其中置换以自筹资金预先投入募集资金为38,661,581.46元),募集资金专户余额为325,786,170.54元。

(二)2019年度募集资金使用情况及结余情况

单位:元

募集资金账户情况	首次公开发行股票募集资金额	非公开发行股票募集资金额
1.募集资金账户期初余额:	46,503,337.33	
2.募集资金账户资金的增加项:	50,248,819.82	377,997,711.41
募集资金流入(注1)		377,647,090.48
利息收入	248,819.82	350,620.93
归还暂时补充的流动资金	45,000,000.00	
自有资金划入募集资金账户(注2)	5,000,000.00	
置换以自筹资金预先投入		38,661,581.46
3.募集资金账户资金的减少项:	96,566,919.76	52,211,540.87
募集资金投入募集项目	47,545,330.35	13,474,772.81
自筹资金投入募集项目	5,000,000.00	
支付银行手续费	4,066.82	75,186.60
首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金	44,017,533.59	
4.募集资金账户期末余额:	185,237.39	325,786,170.54

注1:2019年度公司向五位特定投资者非公开发行普通股(A股)7,006,711股,共计募集资金404,147,090.48元。2019年8月20日,公司募集账户收到国信证券股份有限公司扣除其发行费用后的募集资金377,647,090.48元。

注2:因募集资金投资项目“IC系列的升级研发项目”资金需求,公司2019年1月10日将自筹资金5,000,000.00元划入募集资金账户,并用于项目投入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规,并结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

1、2017年首次公开发行募集资金

公司、子公司及保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农商银行张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019年11月22日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事、监事会均发表了明确同意意见。2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据上述决议,公司在2019年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。为方便账户管理,2019年12月24日公司对北京泰合志恒科技有限公司募集资金专项账户进行销户。

2、2019年非公开发行募集资金

公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及公司子公司豪威半导体(上海)有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专项账户存储情况

截至2019年12月31日止,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

1、2017年首次公开发行募集资金

截至2019年12月31日,2017年首次公开发行募集资金专项账户余额为185,237.39元。

单位:元

序号	账户名称	专户银行名称	账户	存储方式	期末余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160155200002608	活期存款	80.16
2	上海韦尔半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	699641879	活期存款	354.56
3	上海韦尔半导体股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03003216418	活期存款	135,062.06
4	上海韦尔半导体股份有限公司	上海农商银行张江科技支行	50131000602125774	活期存款	49,740.62
5	上海韦劲微电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100000182	活期存款	0.00
6	武汉泰合志恒科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127910638010801	活期存款	0.00
合计					185,237.39

2、2019年非公开发行募集资金

截至2019年12月31日,2019年非公开发行募集资金专项账户余额为325,786,170.54元。

单位:元

序号	账户名称	开户银行	账号	余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200001369	25,660,962.60
2	豪威半导体(上海)有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600001375	0.00
3	豪威半导体(上海)有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100229664	300,125,207.94
合计				325,786,170.54

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年首次公开发行募集资金

本报告期内,本公司实际使用2017年首次公开发行募集资金人民币47,545,330.35元,具体情况详见附表《2017年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2019年非公开发行募集资金

本报告期内,本公司实际使用2019年非公开发行募集资金人民币78,636,354.27元,具体情况详见附表《2019年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行募集资金

本报告期内,2017年首次公开发行募集资金不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、2019年非公开发行募集资金

2019年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司拟置换对“支付中介机构费用”项目预先投入的自筹资金。截至2019年9月3日,公司已支付本次交易相关中介机构费用合计人民币38,661,581.46元,由公司以自有资金进行投入。公司董事会同意公司使用募集资金人民币38,661,581.46元置换募投项目前期投入的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日就上述事项出具了《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZA15616号);独立财务顾问国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年首次公开发行募集资金

2018年7月3日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,总金额不超过5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币4,500万元。

截至2019年7月2日,公司已将总计人民币4,500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户,并